## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-50059

@Int\_Cl\_1

識別記号

庁内整理番号

③公開 昭和63年(1988) 3月2日

Published on March 2, 1988

H 01 L 27/14 H 04 N 5/335 B-7525-5F Q-8420-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

の発明の名称 撮像装置

②特 願 昭62-203582

❷出 願 昭62(1987)8月18日

優先権主張 図1986年8月18日⑬オランダ(NL)⑪8602091

6分発 明 者 マルチヌス・ヨハネ オランダ国5621 ベーアー アインドーフェン フルーネ

ス・ヘンリカス・フア バウツウエツハ1

ン・デ・ステーフ

⑪出, 願 人 エヌ・ベー・フィリツ オランダ国5621 ベーアー アインドーフェン フルーネ

プス・フルーイランペ バウツウエツハ1

ンフアブリケン

砂代 理 人 弁理士 杉村 暁秀 外1名

細

1. 発明の名称 撮像装置

## 2.特許請求の範囲

第1 導電型、それと反対の第2 導電型、第 1 導電型の半導体材料の少くとも3 つの層の 前記電子シャッタが前記の画像情報積分期間中に生じるシャッタパルスを有するシャッタ信号により動作し、第1 導電型の細条状領域と第1 導電型の基板との間の導電接続として前記の電荷接続が延在するようになっていることを特徴とする撮像装置。

- 2 -

- 2. 特許請求の範囲第1項に記載の撮像装置において、前記のシャッタパルスを有するシャッタ信号が前記イメージセンサの撮像装置において前記電極システムの全ての電極に供給されるようになっていることを特徴とする撮像装置。
- 3. 特許請求の範囲第1項に記載の摄像装置において、前記のシャックパルスを有するシャック信号が前記イメージセンサの基板に供給されるようになっていることを特徴とする摄像装置。

## 3. 発明の詳細な説明

本発明はソリッドステートイメージセンサおおび電子シャッタを有する撮像装置であって、前記イメージセンサは半導体基板内に、画像情報積分期間中入射光をバイアスされた半導体接合にまたがる電荷損失に変換する撮像素子と、この撮像素子に結合され、制御信号発生器により生ぜしめられるクロックバルス信号による制御の下で前記の電荷損失を画像信号取出用のセンサ出力端子にシ

フトする並列入力直列出力のシフトレジスクとを 有しており、前記電子シャックは、前記制御信号 発生器により生ぜしめられるシャック信号による 制御の下で画像情報積分期間の一部にわたって前 記攝像案子において電荷接続により動作するよう になっている撮像装置に関するものである。

- **3** -

本発明の目的は所定の既知の種類のソリッドステートイメージセンサに上述したように電子シャッタを有効に用いうるようにすることにある。本発明はソリッドステートイメージセンサおよび電子シャッタを有する摄像装置であって、前記イメージセンサは半導体基板内に、画像情報積分期間中入射光をバイアスされた半導体接合にまたかる電荷損失に変換する撮像素子と、この撮像素子に

結合され、制御信号発生器により生ぜしめられる クロックパルス信号による制御の下で前記の電荷 損失を画像信号取出用のセンサ出力端子にシフト する並列入力直列出力のシフトレジスタとを有し ており、前記電子シャッタは、前記制御信号発生 器により生ぜしめられるシャッタ信号による制御 の下で画像情報積分期間の一部にわたって前記摄 像案子において電荷接続により動作するようにな っている撮像装置において、第1導電型、それと 反対の第2導電型、第1導電型の半導体材料の少 くとも3つの暦の層構造を有するイメージセンサ を用い、ドーピングされた第1導電型の半導体材 料の前記基板が、この基板面上でこの基板より高 濃度にドーピングされた第2導電型の半導体材料 の細条状領域と、さらに高濃度にドーピングされ た第1導電型の半導体材料の細条状領域とを交互 に有しており、この基板内で前記の第2導電型細 条状領域が前記第1導電型細条状領域の下方まで 延在しており、これら第1導電型の細条状領域の 中心軸線の近くでその厚みにおいて減少しており、

- 6 -

前記の細条状領域に対して直角に向けられた電極システムがこのイメージセンサの撮像素子に存在している場合、前記電子シャッタが前記の画像情報積分期間中に生じるシャッタパルスを有するシャック信号により動作し、第1導電型の細条状領域と第1導電型の基板との間の導電接続として前記の電荷接続が延在するようになっていることを特徴とする。

以下本発明を図面につき詳細に説明する。

第1a図はイメージセンサ1の平面図であり、その一点鎖線上を断面とする断面図を第1b図に示す。第1b図の断面に示すように、イメージセンサ1は各々少くとも3つのn刄電型の半導体材料層2と、これと反対のp刄電型の半導体材料層3と、n專電型の半導体材料層3と、n專電型の半導体材料層3と、n專電型の半導体材料層3とのの層を有する層構造をもって構成されている。この代りにp-n-p層構造をも用いることができる。しかしこの場合、後に説明すべき電圧の極性をこれに適合する必要がある。半導体材料層2はnによりしめしてあり、このnは例えば約5×10<sup>11</sup>

原子/cm³ のn型のドーピング濃度を意味する。 半導体材料層2がこのようにドーピングされたn 型半導体材料の基板として存在しており、その中 に半導体材料層 3 および 4 が細条状領域として片 側に交互に存在している。細条状の型領域3は基 板より高いドーピング濃度を有しており、その領 域3の表面におけるドーピング濃度を、例えば約 3×10 15原子/cm² とする。 細条状 n 型領域 4 はさらに高いドーピング濃度を有しており、その 領域4の表面におけるドーピング濃度を、例えば 約10 16原子/cm3 とする。第1 a 図の平面図に はこれら細条状領域を破線により示しており、か つこれら領域をn, p, n, pおよびnにより示 している。基板2中ではp型領域3がn型領域4 の下方まで延在している。これらp型領域3を第 1 b図で互いに離間させて示してあるが、これら 領域は連続層とすることもできる。ただしここで 重要なことは半導体材料層3の厚さを n型領域4 の中心軸線の近くで減少させることである。イメ ージセンサ1は、後に示すようにn型領域4をソ

- 7 -

- R -

ースとして、p型領域3をゲートとして、基板2をドレインとして作用せしめうる"バーチカル"トランジスタ構造を有している。このトランジスタ構造では、光感応p-n半導体接合(3, 4)が領域3および領域4間に存在する。半導体接合(3, 4)がバイアスされた場合には、入射光の光子により生ぜしめされる正孔電子対がこれら接合にまたがって電荷損失を生ぜしめる。

第1b図に示すイメージセンサ1には基板表面上に細条状 n 型領域 4 および p 型領域 3 と、透明 絶縁層 5 とが設けられており、この透明 絶縁層 5 の上には電極細条 6 が存在してある。この電極 6 は でおり、これら電極システムで 6 4 である 4 相電極システム(6 1 ~ 6 4)を、例えば後に記載する文献にして 4 ージセンサの具体例と関連させて示した。

第1a図および1b図のイメージセンサ1は、

第1b図の素子2~6および第1a図の電極システム(61~64)で示した部分に加え、シフト部材7と、センサ出力端子9に結合された並列入力直列出力のシフトレジスタ8とを有している。シフト部材7は画像情報を記憶する記憶部材の形態にすることができる。シフト(および記憶)材7とシフトレジスタ8とは入射光から遮蔽されている。電極システム(61~64)を有する撮像部材は、入射光をバイアスされた半導体接合(3、4)にまたかる電荷損失に変換する撮像部材である。

第1 b 図に示すイメージセンサ 1 の層構造は、 文献 "アイ・イー・イー・イー トランザクショ ン オン エレクトロン デバイシズ (1BEE Transaction on electron devices ) " Vol . ED-32、Ma 8、1985年 8 月 8 日の第1430~1438ページ に "ア フレーム トランスファ シー・シー・ ディー カラー イメージャー ウイズ バチカ ル アンチプルーミング (A Frame Transfer CCD Colour Imager with Vertical Antiblooming)"

と題する章に開示されている。例えば細条状領域 3 および 4 における正確なドーピング濃度分布に 対しては、この文献を参照しうる。この種類のイ メージセンサの制御に対しては、1986年4月 にフィリップス社により発行された、"ザーフレ ーム-トランスファ センサ (The frame-transfer sensor) "と題する技術文献を参照しうる。第 1 a 図では、この技術文献に合せて符号10 は制 御信号発生器を示しており、この制御信号発生器 は、制御信号CP1、CP2、CP3およびCP4 を電極細条状 6 1 , 6 2 , 6 3 および 6 4 に 夫々 供給し、他の制御信号CP7およびCP8をシフ ト (および記憶) 部材 7 および シフトレジスタ 8 に夫々供給するものとする。これら信号CP7お よびCP8を供給する接続リード線に付してある 符号XおよびYは、これらリード線が数本のリー ド線を有する多重形態であることを示している。 シフト信号、クロックパルス信号、それらより長 い持続時間を有するパルスおよびそれらの組合せ の信号を発生するための制御信号発生器10の詳

細な構造に対しては、上記の技術文献を参照しう る。このことに基いて、数個の制御信号線図を制 御信号CP1、CP2、CP3およびCP4に対 する時間 t の関数として第2図に示す。第1 a 図 において、電極システム(61~64)に対する これら制御信号の組合せを以下に説明するシャッ ク信号(CP1~CP4、SP)の一部である CP1~CP4によって示してある。 第2図には いくつかの瞬時t1~t7を示す。瞬時t1の前 および瞬時 t 7 の後には、既知のように制御信号 CP1~CP4内にシフトクロックパルスTPが 存在する。前記技術文献に示されているように2.5 MHzのクロックパルス周波数および4による分 周から始めて、1.6 μ秒のパルス周期を有する 90°移相されたシフトクロックパルスTPが制 御信号発生器10により生ぜしめられる。第2図 には瞬時t1から瞬時t7まで1Tにより表わさ れた画像情報積分期間を示す。第2図中の期間1丁 を各々!T1、「T2および「T3により示す第 1、第2および第3の持続時間に分割する。第2

-11-

図には、一例として瞬時t3および瞬時t5間の

持続時間IT2は4.8μ秒、すなわちパルスTP の周期の3倍と等しいことが示されている。実際 この持統時間は、最小持統時間を目的とする前記 文献に記載されたセンサの具体例における、以下 に説明する効果を得るのに最適であることを確か めた。あるいはまた持続時間IT2を瞬時t3で はなく瞬時 t 1 で開始することができる。このこ とは持続時間IT1が存在しなくなることを意味 する。第2図は、パルスTPが例えば0Vと+10 Vとの間の振幅を有していることも示している。 第1b図には、基板2が例えば+20Vの電圧を 与える接続部に接続されていることを示している。 本発明の主たる特徴は期間 I T の持続時間 I T 2 中、制御信号 СР1~СР4に、すなわちこれら 制御信号の組合せに例えばー5Vの電圧が存在す ることである。第2図にシャッタパルスSPとし て示す-5 Vのパルスが存在するために、シャッ

- 1 2 -

SP) に対して作用する。画像情報積分期間 | Tは、可調整の光非感応持続時間(IT1+IT2)と光感応持続時間 | IT3とに分割される、この場合最大の積分期間である。第2図において符号 | Pは、制御信号CP2、CP3およびCP4において+10 Vの電圧の積分パルスを示している。

以下にイメージセンサ1およびシャック信号(CP1~4、SP)で作動する電子シャック(2~6、SP)の動作を説明する。始動点は第2回に示す瞬時 t 1 である。信号 CP1により電極細条 6 1 に0 Vの電圧が与えられ、電極細条 6 1 に0 Vの電圧が与えられ、電極細条によりこれら細条に十10 Vの電圧が与えられる。+10 Vの電圧が n 型領域 4 から電子を引付け、これにより半導体接合(3、4)がバイアスさる場合には、でででは、なりででは、なりでででは、なりででででいる。映時 t 1 から入りでいる。瞬時 t 1 から入りでの、から電子が引付けられる。瞬時 t 1 から入りでいたがってバ

夕信号(CP1~CP4、SP)は第1図のイメ

ージセンサ1において電子シャック(2~6、

イアスされた半導体接合(3,4)にまたがる電 圧が減少する。半導体接合(3,4)における電 荷損失は電極細条62、63および64の下方の 自由負電荷、すなわちそこに存在し寸法が局部鋒 光の強度およびその持続時間に依存する自由電荷 パケットと対応する。このようにして瞬時 t 2 に 電極細条62、63および64の下方に自由電荷 パケットが生じる。

次に瞬時 t 3に全ての電極細条61~64に - 5 V の電圧が印加される。その結果、ソース 4 およびドレイン2を有する全ての"バーチカル" トランジスタが導通し、電荷接続部(2,3,4) が半導体接合(3,4)に形成される。電荷接続 部 (2, 3, 4) が瞬時 t 3 から瞬時 t 4 まで電 流を流し、瞬時t4から導通状態にバイアスされ、 光子により生ぜしめられた電子がただちに空乏化 される一例を示した。瞬時 t 5 において瞬時 t 1 に対して説明した状態が再現され、瞬時 t 2 に対 応する瞬時 t 6 で光積分が再び開始される。

瞬時 t 7 からは半導体接合(3,4)で生ずる

電荷損失は、既知のように電荷パケットとして電 極システム(61~64)の下方からシフト(お よび記憶)部材7にシフトされる。

前述した層構造およびドーピング濃度を有する イメージセンサ1の構造は、実際に満足な動作を 行なう撮像装置における電子シャッタ(2~6、 SP)となる。バイアスされた光感応半導体接合 (3,4)にまたがる電荷損失およびそれに対応 し電極システム(61~64)の下方にある自由 電荷パケットがシャック動作中補充されたり空乏 化されたりする。

センサ出力端子9に生じる画像信号を、テレビ ジョンにおいて通常の信号処理動作後にテレビジ ョン表示に用いる場合には、撮像装置はテレビジ ョンカメラの一部を形成する。さらに端子9に生 じる画像信号を映画撮影表示に適した信号に処理 することもでき、この場合撮像装置は撮像部材と して映画撮影カメラの一部を形成する。さらに画 像信号を写真記録またはスライド記録に処理する こともでき、この場合、撮像装置は撮像部材とし

- 16 -

- 1 5 -

て写真カメラの一部を形成する。写真記録の間に は、しばしばボーズがある。 撮像部材、記憶部材 およびシフトレジスタ部材を有するイメージセン サ1の上述したフレーム転換設計を基にして、電 子シャッタ (2~6、SP)を、写真記録の場合 に撮像部材おらび記憶部材の双方で電荷接続部 (2.3,4)を得るのに用いることができる。 写真記録の前に前記の2つの部材はクリアされる。 このクリア動作はシャッタ信号(CP1~4、SP) を掲集部材および記憶部材の双方の電極システム に供給することにより実行しうる。写真記録の場 合には、さらに逆極性のシャッタパルスを有する シャッタ信号を撮像部材および記憶部材に共通の 基板に供給することによりクリアシャッタ動作を 行なうこともできる。

4. 図面の簡単な説明

第1a図は、本発明による摄像装置の一部を示

第1b図は、この撮像装置の中にあるイメージ センサの断面を示す断面図、

第2図は、第1a図および第1b図の撮像装置 の動作を説明するための制御信号を時間の関数と

1 … イメージセンサ

2 ··· 半導体材料層 (n型領域:基板)

3 ··· 半選体材料層 (p 型領域)

4 ··· 半導体材料層 (n型領域)

6…質極細条

7 … シフト (記憶) 部材

8 …シフトレジスク 9 …センサ出力端子

10…制御信号発生器 61~64…電極細条

特許出願入 エヌ・ベー・フィリップス・

フルーイランペンファブリケン

代理人弁理士

同 弁 理 士

--301--

